

สร้างสรรค์อุปกรณ์เสียงความละเอียดสูงด้วยชิป

Bluetooth(R) audio SoC รุ่นใหม่จากไมโครชิพ



SoC รุ่นใหม่รองรับ Bluetooth 5.0 เนรมิตเสียงที่ดื่มด่ำเต็มอารมณ์ในหูฟังสำหรับเล่นเกมรุ่น Mobius ซึ่งเป็นหูฟังระดับไฮเอนด์ของ Audeze ที่ได้รับรางวัลการ์นตีมาแล้ว

ปัจจุบันผู้บริโภคต่างก็ต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์ด้านเสียงคุณภาพสูง ความคาดหวังถึงอุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ (Bluetooth audio device) ที่สร้างประสบการณ์การฟังที่ดื่มด่ำและราบรื่นไม่มีสะดุดจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่การออกแบบอุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อบลูทูธถูกจำกัดด้วย Bit Depth และอัตราความถี่ของตัวเข้ารหัสเสียง (codec) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารและบีบอัดข้อมูลเพื่อส่งเสียงผ่านทางอากาศ ด้วยเล็งเห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าว บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด (NASDAQ: MCHP) จึงขอแนะนำ IS2064GM-0L3 ผลิตภัณฑ์ System-on-Chip (SoC) รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับ Bluetooth 5 ทั้งยังมาพร้อม LDAC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงของโซนี่* ที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเหล่านักออกแบบระบบเสียง โดยชิป SoC รุ่นใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาอุปกรณ์เสียงรุ่นใหม่ ๆ ด้วยตัวเข้ารหัสเสียงขั้นสูง ให้คุณภาพเสียงคมชัดรายละเอียดสูงที่เหนือกว่าระดับออดิโอไฟล์ พร้อมขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์บลูทูธไร้สายในตลาดวงกว้าง ผู้ผลิตหูฟังระดับบนอย่าง Audeze ได้เลือกใช้ SoC กับ Mobius ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หูฟังไฮเอนด์สำหรับเล่นเกม รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SoC ตัวใหม่นี้ได้ที่ <http://www.microchip.com/IS2064>

หูฟัง Mobius จาก Audeze ใช้ชิป IS2064GM-0L3 SoC ของไมโครชิพ เพื่อการเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายที่รองรับ LDAC รวมไปถึงเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงแบบอื่น ๆ LDAC ของโซนี่ ได้รับการยอมรับว่าเป็น audio codec ที่มีคุณภาพดีที่สุดในท้องตลาดปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 990 kbps ซึ่งสูงกว่า Bluetooth Sub-band Codec (SBC) แบบมาตรฐานถึงสามเท่า อีกทั้งยังคงระดับความลึกและความถี่ปิดสูงสุดสูงสุดอยู่ที่ 96 kHz/24 บิต นอกจากนี้ยังให้ประสิทธิภาพการบีบอัดและการสร้างซ้ำที่ดี จึงมอบประสบการณ์การฟังคุณภาพเสียงคมชัดระดับ High-Resolution สำหรับอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อบลูทูธ

“หูฟัง Mobius รุ่นใหม่ของเราพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำมากมาย และเพื่อรับรองว่าอุปกรณ์บลูทูธออดิโอจะให้เสียงคุณภาพสูง เราจึงเลือกใช้ IS2064GM-0L3 SoC ของไมโครชิพในหูฟังของเรา” Sankar Thiagasamudram ซีอีโอของ Audeze กล่าว “ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากไมโครชิพ เราจึงสามารถรวม LDAC codec เข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว”

IS2064GM-0L3 SoC ไม่เพียงทำให้ LDAC codec เข้าถึงตลาดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงในวงกว้างมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดทางให้ลูกค้าสามารถรับการสนับสนุนทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมจากไมโครชิพ รวมถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าว และนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ LDAC codec ยังถูกรวมเข้ากับ Bluetooth stack ระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo(TM) ทำให้เทคโนโลยี LDAC มีความแพร่หลายมากขึ้นในด้าน transmit side อีกด้วย

“ไมโครชิพช่วยให้ผู้ผลิตในกลุ่ม OEMs สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในด้านระบบเสียงคุณภาพสูง ด้วยความสะดวกและความแพร่หลายของบลูทูธไร้สาย” สตีฟ คัลด์เวล รองประธานกลุ่มโซลูชันไร้สายของไมโครชิพ กล่าว “OEMs จะมุ่งความสนใจไปที่ผลิตภัณฑ์ที่อัดไอและคุณภาพเสียงได้อย่างเต็มที่ และเพราะไมโครชิพ การรวมพีเออร์บลูทูธไร้สายจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว”

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา

ลูกค้าสามารถขอรับ IS2064GM-0L3 หลังได้รับการอนุมัติ รวมทั้งมี Development Board แบบต่าง ๆ ไว้รองรับการพัฒนาเช่นกัน

การวางจำหน่าย

The IS2064GM-0L3 มาในแพ็คเกจ LGA ขนาด 8 x 8 มม. และรับสั่งผลิตปริมาณมากถึง 10,000 ชิ้น กรุณาติดต่อโซนี่ เพื่อขอใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับการใช้เทคโนโลยี LDAC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนขายของไมโครชิพ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของไมโครชิพ หรือส่งอีเมลไปที่ BTAudio@microchip.com

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไลนส์ผลิตภัณฑ์ Bluetooth audio ทั้งหมดของไมโครชิพ ได้ที่:

www.microchip.com/design-centers/wireless-connectivity/bluetooth/applications/audio

แหล่งข้อมูลและภาพ

ดูรูปภาพความละเอียดสูงได้ที่ Flickr หรือติดต่อกองบรรณาธิการ (สามารถนำไปเผยแพร่ได้ตามสะดวก):

- ภาพการใช้งาน: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/43218806091/sizes/l
- ภาพกราฟฟิกรูป: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/28349047627/sizes/l

เกี่ยวกับไมโครชิพ เทคโนโลยี

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด (NASDAQ: MCHP) เป็นผู้นำด้านการจัดหา Solution ของไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรรวมแบบผสมสัญญาณ แอนะล็อก และแฟลช-ไอพี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยัง

ช่วยลดต้นทุนโดยรวมของทั้งระบบ และยังช่วยลดระยะเวลาการออกแบบและพัฒนาของลูกค้าในตลาดทั่วโลกกว่า พันราย สำนักงานใหญ่ของไมโครชิพตั้งอยู่ที่เมืองแซนด์เลอร์ รัฐแอริโซนา บริษัทนำเสนอการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เป็นเลิศ พร้อมกับการขนส่งและคุณภาพที่เชื่อถือได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไมโครชิพที่ www.microchip.com

หมายเหตุ: ชื่อและโลโก้ The Microchip และโลโก้ Microchip เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท โซนี่ คอร์ปอเรชั่น *การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง LDAC ต้องขอใบอนุญาตต่างหากจากบริษัท Sony Video & Sound Products Inc ขณะที่ Android 8.0 Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google LLC เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุถึงในข่าวฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180713/2186418-1>